

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-046

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年4月22日召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，拟调整“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”、“年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额339,000万元可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为339,000.00万元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币1,187.59万元后，实际募集资金净额为人民币337,812.41万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]7581号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金使用情况

截至2024年4月12日，公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

| 序号 | 募投项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金累计投入金额 | 投入进度(%) |
|----|----------------------|------------|------------|---------|
| 1 | 年产180万片12英寸半导体硅外延片项目 | 113,000.00 | 39,693.85 | 35.13 |
| 2 | 年产600万片6英寸集成电路用 | 125,000.00 | 79,665.58 | 63.73 |

| 序号 | 募投项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金累计投入金额 | 投入进度 (%) |
|----|--------|------------|------------|----------|
| | 硅抛光片项目 | | | |
| 3 | 补充流动资金 | 101,000.00 | 99,974.40 | 98.98 |
| | 合计 | 339,000.00 | 219,333.83 | 64.70 |

三、关于募集资金投资项目延期的具体情况

(一) 本次延期的募集资金投资项目情况

公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

| 序号 | 募投项目名称 | 项目达到预定可使用状态时间 | |
|----|---------------------------|---------------|------------|
| | | 调整前 | 调整后 |
| 1 | 年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目 | 2024 年 5 月 | 2026 年 5 月 |
| 2 | 年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目 | 2024 年 5 月 | 2026 年 5 月 |

(二) 本次募集资金投资项目延期原因

公司受外部宏观经济环境影响，公司所处行业市场景气度偏弱，导致市场需求下降。为保障公司和中小股东利益、降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用和投产后的项目经济效益，结合公司实际经营情况及市场环境等因素，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，稳步推进募集资金投资项目的实施，故募集资金投资项目未达到计划进度。经过审慎研究，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将上述项目完成期限延长至 2026 年 5 月。

四、部分募投项目重新论证的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对投入进度未到 50%的“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”进行了重新论证，具体情况如下：

(一) 项目建设的必要性

从半导体行业发展历程及前景来看，大尺寸半导体硅片是全球及国内半导体领域重点发展方向，已成为市场主流。半导体硅外延片的应用主要包括 MOSFET、晶体管等功率器件，及 CIS、PMIC 等模拟器件和逻辑电路，终端应用包括汽车、高端装备制造、能源管理、通信、消费电子等，未来需求回暖后前述行业仍将不断发展，半导体硅外延片市场规模也将持续增长。

公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片项

目”已经建成，该项目在 180 万片 12 英寸硅抛光片的产能基础上仅配套 120 万片 12 英寸硅外延片的生产能力，嘉兴金瑞泓也将于 2024 年底建成年产 180 万片 12 英寸硅抛光片的产能。而通过本项目的实施，公司将新增年产 180 万片 12 英寸硅外延片的生产能力，可以使得公司产品结构得到进一步优化。本项目实施后，公司将进一步提升 12 英寸硅片在公司产品中的占比，提升公司的综合竞争力。

（二）项目建设的可行性

半导体硅片行业属于我国重点鼓励、扶持发展的战略新兴产业。随着未来 5G、算力、大数据、人工智能等技术的大规模应用，12 英寸硅片的需求将持续增长，为本项目的实施提供了市场保障。公司在半导体硅片生产方面的核心技术具备行业领先性，荣获国家技术发明奖二等奖、浙江省技术发明一等奖、中国半导体创新产品和技术奖等重要荣誉。凭借强大的研发团队以及深厚的技术积累，公司成为了行业中具有较强影响力的硅片龙头企业，为本项目的实施奠定了坚实基础。

（三）项目预计收益

本项目预计收益未发生重大变化。

（四）结论分析

公司认为“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”可行性与必要性未发生重大变化，符合公司长远战略规划，公司将继续实施该项目并将该项目实施期限进行调整。公司将持续关注外部环境变化，并对募集资金进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

五、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

公司本次部分募集资金投资项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期系公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，稳步推进募集资金投资项目的实施，维护全体股东的利益，且本次部分募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序

（一）董事会意见

公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延

期的议案》，同意公司对募投项目“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”、“年产 600 万片 6 英寸集成电路用硅抛光片项目”预定达到可使用状态的时间调整延长。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。监事会认为：公司本次调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响；上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日